# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-012682

(43) Date of publication of application: 15.01.2002

(51)Int.Cl.

CO8J 7/00 B29C 39/16 CO8J 5/18 // CO8F 2/48 B29L 7:00 CO8L 57:00

(21)Application number: 2000-198136

(71)Applicant: MITSUBISHI CHEMICALS CORP

(22)Date of filing:

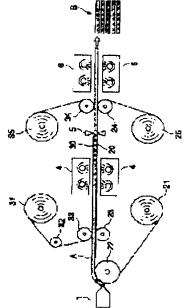
30.06.2000

(72)Inventor: MIWA YASUSHI

SAITO NORIYUKI **ISHIHARA MITSURU** 

### (54) METHOD FOR CONTINUOUSLY PRODUCING TRANSPARENT RESIN SUBSTRATE (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for stably and continuously producing a transpar ent resin substrate having a uniform and smooth surface. SOLUTION: This method for continuously producing a transparent resin substrate is to feed a photopolymerizable monomer composition (A) on a lower conveyed support sheet (20), laminate an upper support sheet (30) conveyed in the same speed and direction as those of the lower support sheet on the lower support sheet and subsequently irradiate active rays on the photopolymerizable monomer composition and consists of a previous curing process (4) in which the active rays are irradiated through the lower support sheet and/or the upper support sheet and a post-curing process (6) in which the active rays are irradiated after peeling off the both support sheets. The amount of the active rays in the post-curing process (6) is brought to 1.5-20 times of that in the previous curing process (4).



## 引用文献: 2

(19)日本国特許庁 (JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開番号 特開2002-12682

(P2002 - 12682A)

(43)公開日 平成14年1月15日(2002.1.15)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FI	デーマコート*(参考)
C 0 8 1	7/00	CER	C08J 7/00 CER	4 F 0 7 1
		3 0 4	3 0 4	4F073
B 2 9 C	39/16		B 2 9 C 39/16	4 F 2 O 4
C 0 8 J	5/18	CER	C 0 8 J 5/18 CER	4 J O 1 1
# C08F	2/48		C08F 2/48	
			審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 9	頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特臘2000-198136(P2000--198136)
(22) 出顧日 平成12年6月30日(2000.6.30)

(71) 出職人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 発明者 三輪 靖

神奈川県横浜市青葉区鴨志田町1000番地

三菱化学株式会社横浜総合研究所内

(72)発明者 斉藤 範之

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石1番1号

三菱化学株式会社風筒事業所内

(74)代理人 100097928

弁理士 岡田 数彦

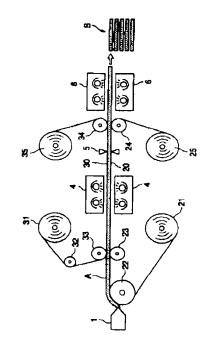
最終質に続く

#### (54) 【発明の名称】 透明樹脂基板の連続的製造方法

#### (57)【要約】

【課題】均一且つ平坦な表面を有する透明樹脂基板の安定した連続的製造方法を提供する。

【解決手段】移送される下部支持シート(20)上に光重合性モノマー組成物(A)を供給し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シート(30)を積層した後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連続的製造方法であって、下部支持シート及び/又は上部支持シートを透過させて活性線の照射を行なう前段硬化工程(4)及び両支持シートを剥離した後に活性線の照射を行なう後段硬化工程(6)より成り、しかも、後段硬化工程(6)における性線の照射量を前段硬化工程(4)の1、5~20倍とする。



;÷.

特開2002-12682

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 】】 移送される下部支持シートトに光重合性 モノマー組成物を供給し、その上に下部支持シートと同 速度で同一方向に移送される上部支持シートを積層した 後、光重合性モノマー組成物に活性線を照射して硬化さ せる透明樹脂基板の連続的製造方法であって、下部支持 シート及び/又は上部支持シートを透過させて活性線の 照射を行なう前段硬化工程、および、両支持シートを剥 離した後に活性線の照射を行なう後段硬化工程より成 硬化工程の1.5~20倍としたことを特徴とする透明 樹脂基板の連続的製造方法。

1

【請求項2】 前段硬化工程における光重台性モノマー 組成物の温度を100~150℃に制御する請求項1に 記載の製造方法。

【請求項3】 前段硬化工程における光重合性モノマー 組成物の温度を140~180℃に制御する請求項1又 は2に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、透明樹脂基板の連 続的製造方法に関し、詳しくは、均一旦つ平坦な表面を 有する透明樹脂基板の安定した連続的製造方法に関す る。

(0002)

【従来の技術】透明樹脂基板は、工業的には、液晶、有 機ELなどのディスプレー基板、光学フィルター、光通 信材料、太陽電池基板などの各種用途に利用されてい る。斯かる透明樹脂基板は、移送される下部支持シート 持シートと同速度で同一方向に移送される上部支持シー トを積層し、次いで、光重合性モノマー組成物に活性線 を照射して硬化させた後に両支持シートを剥離する方法 により、連続的に製造するととが出来る。通常、上記の 支持シートには合成樹脂シートが使用される。

【0003】ととろで、上記の方法においては、活性線 の照射により、支持シートが熱収縮し、シート状に成形 された光重合性モノマー組成物との間にズレを生じる。 そのため、均一且つ平坦な表面を有する透明樹脂基板の 連続的製造は困難である。また、時として、下部支持シ 40 ート上にシート状に成形された光重合性モノマー組成物 の破断が生じ、長期間に亘る安定した製造が困難とな る。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記実情に 鑑みなされたものであり、その目的は、均一旦つ平坦な 表面を有する透明樹脂基板の安定した連続的製造方法を 提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の目 的を達成すべく種々検討を重ねた結果、意外にも、活性 線の照射による硬化工程を2段に分け、前段硬化工程の 後に支持シートを剥離してから段硬化工程を行ない、し かも、後段硬化工程における性線の照射量を前段硬化工 程の1.5~20倍とするならば、上記の目的を容易に 達成し得るとの知見を得、本発明の完成に至った。

【0006】すなわち、本発明の要旨は、移送される下 り、しかも、後段硬化工程における性線の照射量を前段 10 部支持シート上に光重合性モノマー組成物を供給し、そ の上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送される 上部支持シートを積層した後、光重合性モノマー組成物 に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連続的製 造方法であって、下部支持シート及び/又は上部支持シ ートを透過させて活性線の照射を行なう前段硬化工程。 および、両支持シートを剥離した後に活性線の照射を行 なう後段硬化工程より成り、しかも、後段硬化工程にお ける性線の照射量を前段硬化工程の1.5~20倍とし たことを特徴とする透明樹脂基板の連続的製造方法に存 20 する。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明を添付図面に基づき 詳細に説明する。図1は本発明を実施するための製造設 備の好ましい―例の説明図である。

【0008】先ず、本発明で使用する光重合性モノマー 組成物について説明する。本発明で使用する光重合性モ ノマー組成物は、重合性モノマーと光重合開始剤と任意 の他の成分とから構成される。

【0009】上記の重合性モノマーとしては、紫外線な 上に光重合性モノマー組成物を供給し、その上に下部支 30 どの活性線の照射によって重合・硬化することにより透 明樹脂を形成し得るモノマーである限り、特に制限され ず、各種のモノマーを使用することが出来る。代表的に は各種のアクリレート化合物、例えば、エポキシアクリ レート、ウレタンアクリレート、ポリエステルアクリレ ート、ポリエーテルアクリレート、これらのオリゴマ ー、または、これらと他の重合性モノマーとの組み合せ 等が挙げられる。

> 【0010】本発明においては、耐薬品性、剛性などの 観点から、次の一般式(Ⅰ)で表される含脂環骨格ビス (メタ)アクリレート、次の一般式(II)で表される含 脂環骨格モノ(メタ)アクリレートの組み合せが好適で あり、特に、これらと後述の二官能性メルカプト化合物 との組み合せが好適である。なお、「(メタ)アクリレ ート」は、アクリレートとメタクリレートを含む総称で

[0011]

[{{k1}}

$$\begin{array}{c} (3) \\ (3) \\ (CH_{2}C - C - C - CH_{2})_{p} \\ (CH_{2})_{q} \\$$

【0012】一般式(1)中、R'及びR'は、それぞれ 独立して、水素原子またはメチル基を示し、喊は1又は 2の整数、nは0又は1の整数、p及びqは、それぞれ 独立して、0~3の何れかの整数を表す。

【0013】上記の式(1)で表される含脂環質格ピス (オキシメチル)トリシクロ[5.2.1.02.6]デ カン=ジアクリレート、ビス (オキシメチル) トリシク ロ[5, 2, 1,  $0^{3,6}$ ] デカン=ジメタクリレート、 ピス (オキシメチル) トリシクロ [5.2.1. 0\*.\*] デカン=アクリレートメタクリレート及びこれ らの混合物、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ[6. 5. 1. 1<sup>3.6</sup>. 0<sup>3.7</sup>. 0<sup>3.13</sup>] ペンタデカン=ジアク\*

\* リレート、ビス(オキシメチル)ペンタシクロ [6. 5. 1. 11.6. 01.7. 01.11] ペンタデカン=ジメタ クリレート、ビス (オキシメチル) ペンタシクロ [6. 5. 1. 13.6. 04.7. 09.13] ペンタデカン=アクリ レートメタクリレート及びこれらの混合物、ビス(オキ (メタ) アクリレートの具体例としては、例えば、ビス 10 シメチル) トリシクロ [5.2.1.0\*\*] デカン= ジアクリレート、ビス (オキシメチル) トリシクロ  $[5. 2. 1. 0^{1.6}]$   $\vec{r}$   $\vec{n}$   $\vec{n}$  ス(オキシメチル)トリシクロ「5.2.1.0\*\*) デカンニアクリレートメタクリレート及びこれらの混合 物などが挙げられる。

> [0014] [化2]

$$CH_{2} = C - C - O + CH_{2}$$
,  $CH_{2} = CH_{2} + OH$  (II)

【0015】一般式(II)中、R<sup>3</sup>は水素原子またはメ チル基を示し、mは1又は2の整数、nは0又は1の整 数、r及びsは、それぞれ独立して、0~3の何れかの整 数を表す。

【0016】上記の一般式(II)で表される含脂環骨格 モノ(メタ)アクリレートの具体例としては、例えば、 ビス (オキシメチル) トリシクロ [5.2.1. 01-6] デカン=モノアクリレート、ビス (オキシメチ ル) トリシクロ[5, 2, 1, 01・1] デカンニモノメ タクリレート及びこれらの混合物、ビス (オキシメチ ル)ペンタシクロ[6, 5, 1, 11\*\*, 01\*\*. 0\*.13] ペンタデカン=モノアクリレート、ビス (オキ シメチル) ベンタシクロ [6.5.1.1'\*\*.0''、※

$$\left(HS - H^4 - C - O \right) = H^5$$

【0019】一般式(III)中、R'はメチレン基または エチレン基を示し、R'はエーテル酸素を含んでいても よい炭素数2~15の炭化水素残基を示し、aは2~6 の整数を示す。

【0020】一般式 (III) において、R<sup>5</sup> (エーテル酸 素を含んでいてもよい炭素数2~15の炭化水素残基) の具体例としては、例えば、ベンタエリスリトール残 基、ジベンタエリスリトール残基、トリメチロールプロ パン残基、エチレングリコール残基、ジエチレングリコ ール残基、トリエチレングリコール残基、ブタンジオー ル残基などが挙げられる。

※ 0<sup>9,13</sup>] ペンタデカン=モノメタクリレート及びこれら の混合物、ピス(オキシメチル)トリシクロ[5,2] 1. 01.6] デカン=モノアクリレート、ビス (オキシ メチル)トリシクロ [5.2.1.01.6] デカン=モ ノメタクリレート及びこれらの混合物などが挙げられ

【0017】含脂環骨格ピス(メタ)アクリレート及び 含脂環骨格モノ(メタ)アクリレートと組み合わせて使 30 用される二官能性メルカプト化合物としては、一般式 (III)~(V)で表されるメルカプト化合物が好適であ る。

[0018]

[123]

(III)

【0021】一般式(III)で表されるメルカプト化合 物は、2~6価のチオグリコール酸エステル又はチオブ 40 ロピオン酸エステルであり、その具体例としては、例え は、ペンタエリスリトールテトラキス (β-チオプロビ オネート)、ペンタエリスリトールテトラキス (チオグ リコレート)、トリメチロールプロパントリス (β-チ オプロピオネート)、トリメチロールプロパントリス (チオグリコレート)、エチレングリコールビス (B-チオプロピオネート)等が挙げられる。

[0022]

(1t4)

· per

【0023】一般式 (IV) 中、XはHS-(CH,)。-CO-(0 CH, CH, )。-(CH, )。-を示す。但し、b及びcは、それ それ独立して1~8の整数を示す。

【0024】一般式 (IV) で表されるメルカプト化合物 10 はωーチオール基含有イソシアヌレートであり、その具 体例としては、例えば、トリス[2-(8-チオプロピ オニルオキシ) エチル] イソシアヌレート、トリス (2 - チオグリコニルオキシエチル) イソシアヌレート、ト\*

\*リス[2-(β-チオグリコニルオキシエトキシ)エチ ル] イソシアヌレート、トリス[(2-チオグリコニル オキシエトキシ) エチル] イソシアヌレート、トリス [3-(β-チオプロピオニルオキシ)プロピル]イソ シアヌレート、トリス(3-チオグリコニルオキシプロ ピル)イソシアヌレート等が挙げられる。 [0025]

[化5]

$$HS \xrightarrow{\left(-R^{q}\right)} \left(-R^{7}\right) \cdot S \xrightarrow{g} H \tag{V}$$

【0026】一般式 (V) 中、R\*及びR'はそれぞれ独 立してアルキレン基を示し、e及びfはそれぞれ独立し て0又は1の整数を示し、gは1又は2の整数を示す。 【0027】一般式(V)で表される化合物はチオール 基含有炭化水素であり、その具体例としては、例えば、 ベンゼンメルカプタン、キシリレンメルカプタン、4, 4' -ジメルカプトジフェニルスルフィド等が挙げられ る。

【0028】本発明において、上記の各成分は、通常。 次の様な割合で使用される。すなわち、一般式(1)で 表される含脂環骨格ビス(メタ)アクリレートは70~ 99重量部、一般式(II)で表される含脂環骨格モノ 量100重量部に対し、上記の一般式 (III) ~ (V) で表されるメルカプト化合物は1~10重量部である。 【0029】上記の光重合開始剤としては、活性線の照 射によってラジカルを発生し得る限り、特に制限され ※

【0033】一般式 (VI) 中、R\*は、メチル基、メト キシ基または塩素原子を示し、nは2又は3の整数示 す。

【0034】上記の一般式 (VI) で表される化合物の 具体例としては、例えば、2、6-ジメチルベンソイル ジフェニルホスフィンオキシド、2、4、6~トリメチ ルベンソイルジフェニルホスフィンオキシド、2,4, 6-トリメチルベンゾイルフェニルホスイフィン酸メチ ルエステル、2,6-ジクロロベンゾイルフェニルホス フィンオキシド等が挙げられる。

【0035】上記の光重合開始剤は、モノマー100重

※ ず、各種の光重合開始剤を使用することが出来る。代表 的には各種のアセトフェノン系またはベンゾフェノン系 20 の光重合開始剤が挙げられる。

【0030】上記のアセトフェノン系光重合開始剤の具 体例としては、例えば、1-フェニル-2-ヒドロキシ -2-メチルプロパン-1-オン、1-ヒドロキシシク ロヘキシルフェニルケトン、4-ジフェノキシジクロロ アセトフェノン等が挙げられ、上記のベンゾフェノン系 光重合開始剤としては、ベンゾフェノン、ベンゾイル安 息香酸メチル、4-フェニルベンゾフェノン、ヒドロハ シベンゾフェノン等が挙げられる。

【0031】また、本発明においては、次の一般式 (x (メタ)アクリレートは1~30重量部、とれらの合計 30 I)で表される化合物も光重合開始剤として好適に使用 することが出来る。

[0032]

[16]

(VI)

02~0.3重量部の割合で使用される。

【0036】本発明においては、任意の他の成分とし て、ラジカル重合可能な他の重合性モノマー、増粘剤、 熱重合開始剤、酸化防止剤、紫外線吸収剤、染顔料など を使用することが出来る。

【0037】ラジカル重合可能な他の重合性モノマーと しては、例えば、メタクリロイルオキシメチルシクロデ カン、2、2ービス[4-(β-メタクリロイルオキシ エトキシ)フェニル]プロパン、2,2-ビス[4-(β-メタクリロイルオキシエトキシ)シクロヘキシ ル] プロパン、1、4 - ピス(メタクリロイルオキメチ 量部に対し、通常0.01~1重量部、好ましくは0. 50 ル)シクロヘキサン等が挙げられる。これらの重合性モ

"Harrer"

特開2002-12682

8

ノマーは、前述の重合性モノマー100重量部に対し、 通常30重量部以下の割合で使用される。

【0038】増粘剤としては、使用する重合性モノマー の種類より適宜選択されるが、通常、非晶質熱可塑性ポ米

$$\frac{-\left\{(X)_{d} - \left(CH_{2} - CH_{1}\right)\right\}_{e}}{\left(CH_{2} - CH_{2}\right)}$$

\*リマーが使用される。特に次の一般式(VII)又は(VII I) で表される非晶質ポリオレフンが好適である。

[0039]

[{£7]

(VII)

【0040】一般式(VII)中、Xは、シクロペンタジ エン及びその誘導体、ノルボルナジェン及びその誘導 体、ジシキロペンタジエン及びその誘導体、または、と れらの水素添加物を示し、R°は、水素原子、炭化水素 基またはC。H、R1°基を示し、R1°は、水素原子、炭化※

※水素基、アルコキシ基、ハロゲン化炭化水素基またはハ 10 ロゲン原子を示し、d及びeは、それぞれ独立して1以 上の整数を示す。

[0041]

(1t8)

【0042】一般式(VIII)中、」及びkは、それぞれ 20★くはその誘導体と、シクロベンテン、シクロオクテン、 独立して0又は1以上の整数を示す。また、環状5員環 単位はハロゲン原子または炭化水素基などの置換基を有 していてもよい。

【0043】上記の様な非晶質ポリオレフンの具体例 は、特開平10-77321号公報に記載されているの でそれを参照するととが出来る。また、本発明において は、他の非晶質ポリオレフンとして、上記の公開公報に 記載の、ビシクロ[2.2.1]ヘプト−2~エン若し★

1.5-シクロオクテンタジェン等の他の環状オレフィ ンとの開環重合体またはその水素添加物も使用すること が出来る。

【0044】更に、本発明においては、次の一般式(エ X) で表される化合物も増粘剤として好適に使用すると とが出来る。

[0045]

[{k9]

(IX)

【0046】一般式 (IX) 中、Yは、例えば、メトキ シ、エトキシ、イソプロボキシ等のアルコキシ基を示 し、hは1以上の整数を表す。

【0047】上記の増粘剤は、モノマー100重量部に 対し、通常2~10重量部、好ましくは4~8重量部の 割合で使用される。

【0048】本発明で使用する光重合性モノマー組成物 は、上記の各成分の配合によって調製され、非溶媒系で あり、その粘度は、20℃において、剪断速度10se cつの条件下に測定した値として、通常500~100 000mPa·sec、好ましくは1000~1000 OmPa·secの範囲とされる。

【0049】上記の熱重合開始剤としては、ベンゾイル パーオキシド、ジイソプロピルパーオキシカーボネー ト、t-ブチルパーオキシ(2-エチルヘキサノエー

ト)等が挙げられ、その使用量は、モノマー100重量 部に対し、通常1重量部以下である。また、酸化防止 剤、紫外線吸収剤、染顔料としては、公知のものを適宜 選択して使用することが出来る。

【0050】本発明の製造方法は、基本的には、移送さ れる下部支持シート上に光重合性モノマー組成物を供給 し、その上に下部支持シートと同速度で同一方向に移送 される上部支持シートを積層した後、光重合性モノマー 組成物に活性線を照射して硬化させる透明樹脂基板の連 統的製造方法である。斯かる方法は、図1に示す様な製 造設備で行なうことが出来る。

【0051】図1において、下部支持シート(20) は、下部支持シート送給装置(21)から送り出され、 駆動ローラ(22)、案内ローラ(23)及び(24) 50 を経由し、下部支持シート巻取装置(25) に巻き取ら margin

\*= ;: .

特開2002-12682

70

れる。一方、上部支持シート(30)は、上部支持シー ト送給装置(31)から送り出され、案内ローラ(3 2)、(33)及び(34)を経由し、上部支持シート 巻取装置(35)に巻き取られる。下部支持シート側に 配置される案内ローラ(23)及び(24)と上部支持 シート側に配置される案内ローラ(33)及び(34) は、それぞれ、対向して配置されている。

【0052】下部支持シート(20)及び上部支持シー ト(30)は、共に可撓性シートで構成され、また、後 述する活性線の照射側のシートは透明シートで構成され 10 る。また、重合時の熱によって軟化しない様に通常10 ○℃以上の軟化点を有するシートで構成される。斯かる 特性のシートとしては、厚さ50~300 $\mu$ mの合成樹 脂シート、例えば、ポリエチレンテレフタレート、ポリ エチレンナフタレート、ポリカーポネート等の合成樹脂 シートが挙げられる。また、支持シートの光重合性モノ マー組成物と接する側の表面粗さ(Ra)は、通常10 Onm以下、好ましくは20nm以下とされる。斯かる 支持シートとの使用により、その表面がより一層平滑な 透明樹脂基板が得られる。

【0053】下部支持シート(20)と上部支持シート (30)は、同速度で同一方向に移送され、駆動ローラ (22)から案内ローラ(23)及び(24)の間には 水平なパスライが形成されている。シートの移送速度 は、通常0.5~20m/min、好ましくは1~10 m/mınとされる。

【0054】そして、駆動ローラ(22)の近傍に配置 されたダイコーター(1)から、下部支持シート(2) 0)上に光重合性モノマー組成物(A)を供給し、その 上に上部支持シート(30)を積層した後、光重合性モ 30 ノマー組成物に活性線を照射して硬化させる。

【0055】ダイコーター(1)から下部支持シート (20)上に供給される光重合性モノマー組成物 (A) の厚さは、その供給速度とシートの移送速度とにより適 宜調節されるが、通常0.1~5mmとされる。上部支 持シート(30)は、特に加圧される必要はなく、下部 支持シート(20)上に供給され且つシート状に成形さ れた光重合性モノマー組成物(A)に均一に積層される 程度に押圧されればよい。活性線の光源としては、ケミ 銀ランプ、メタルハライドランプ等が使用される。

【0056】本発明の製造方法の最大の特徴は、下部支 持シート(20)及び/又は上部支持シート(30)を 透過させて活性線の照射を行なう前段硬化工程。およ び、両支持シート(20)及び(30)を剥離した後に 活性線の照射を行なう後段硬化工程より成る点にある。 【0057】すなわち、図1に示す様に、先ず、前段硬 化工程用活性線照射設備(4)で活性線の照射を行な い、次いで、両支持シート(20)及び(30)を夫々 の巻取装置(25)及び(35)で剥離した後、後段硬 50 を切断するならば、製品の破損が防止される利点があ

化工程用活性線照射設備(6)で活性線の照射を行な う。図1に示す製造設備の場合、活性線の照射は、両工 程共に両シート面から行なっているが、一方のシート面 から行なってもよい。

【0058】本発明の他の特徴は、後段硬化工程におけ る性線の照射量を前段硬化工程の1.5~20倍とした 点にある。後段硬化工程における性線の照射量は、好ま しくは、前段硬化工程の5~10倍である。そして、活 性線の照射強度は、両工程共に約60~200w/c m、照射時間は、前段硬化工程の場合0.5~3分、後 段硬化工程の場合2~5分とされる。斯かる硬化条件の 採用により前段硬化工程では、通常5~85%、好まし くは20~60%の光重合性モノマーの重合が行われ、 後段硬化工程においては、残余の光重合性モノマーの重 合が行なわれる。硬化条件としては次の様な条件が推奨 される。

【0059】また、光重合性モノマー組成物(A)の温 度は、重合熱によって昇温する。本発明の場合、適宜の 冷却手段により、光重合性モノマー組成物(A)の温度 20 は、前段硬化工程で約100~150℃、後段硬化工程 で約140~180°Cの範囲に制御するのが好ましい。 斯かる温度制御により、製品物性(透明性、強度、均質 性など)の低下が抑制される。また、活性線照射設備と しては市販の設備を利用することが出来るが、後段硬化 工程の雰囲気は窒素などの不活性雰囲気とするのが好ま しい。なお、前段硬化工程の雰囲気は大気雰囲気であっ てもよい。

【0060】また、後段硬化工程においては、前段硬化 工程で得られた重合シート(完全硬化前の透明樹脂基 板) に対して、長さ方向に O. 2~1 N/cm²の張力を 掛け、且つ、幅方向に長手方向の1/5~3/4の張力 を掛けるのが好ましい。斯かる態様の後段硬化工程によ れば、重合シートの歪み(うねり)が防止され、より一 層平坦な透明樹脂基板が得られる。重合シートの長さ方 向および幅方向に張力を掛ける方法としては、例えば、 連続する多数のクリップが耳部を挟んで引張って走行す るテンタークリップ方式を採用することが出来る。

【0061】図1に示す製造設備の場合は、前段硬化工 程用活性線照射設備(4)と後段硬化工程用活性線照射 カルランプ、キセノンランプ、低圧水銀ランプ、高圧水 40 設備(6)との間に耳部切断用カッター(5)が配置さ れている。とれにより、硬化したシート状光重合性モノ マー組成物の長手方向両端部の耳部(盛り上がり部)が 除去される。通常、耳部は、支持シートの剥離後、所定 サイズに切断する製品化工程で一緒に切断して除去され る。斯かる方法による場合は、耳部の切断の際に製品が 破損して製品歩留まりが低下するという問題がある。と とろが、上記の様に、両支持シート(20)及び(3 ○)を夫々の巻取装置(25)及び(35)で剥離する 前に耳部を切断する、すなわち、支持シートと共に耳部

12

(7)

特開2002-12682

る。耳部切断用カッター(5)としてはレーザーカッタ 一が好適に使用される。支持シートと共に切断して除去 された耳部は、耳部巻取ローラ(図示せず)に巻き取ら れる。

【0062】上記の後段硬化工程終了後、得られた透明 樹脂基板は、適宜の手段で切断され、透明樹脂基板製品 (B)とされる。本発明においては、後段硬化工程終了 後であって上記の切断処理前において、必要に応じて熱 処理するととが出来る。斯かる熱処理は、重合処理の仕 上げてとしての意味を有する。熱処理温度は、通常、1 10 た。 50~200℃、好ましくは150~170℃とされ、 熱処理時間は、通常0.5時間以上、好ましくは0.5 ~2時間とされる。雰囲気は、不活性雰囲気または大気 雰囲気の何れであってもよい。

【0063】なお、図示を省略したが、後段硬化工程に ベルトコンベアを配置することが出来る。この場合は、 通常、当該ベルトコンベアの上側に配置される活性線照 射設備のみで後段硬化が行なわれる。また、図1に示す 製造設備の場合、下部支持シート(20)がベルトコン ベルトコンベアを配置し、当該ベルトコンベアの上に下 部支持シート(20)を載せて移送してもよい。更に、 一方の支持シート (好ましくは下部支持シート) はシー ムレスのエンドレススチールシートで構成し、支持シー トとして使用後に廃棄される合成樹脂シートの量を削減 してコストダウンを図ることも出来る。

【0064】本発明に係る方法で得られる透明樹脂基板 は優れた光線透過率を有し、その透過率は、通常75% 以上、好ましくは80%以上である。また、透明樹脂基 板の厚さは、その用途によって異なるが、通常0、 $1\sim$  30 空冷により160 ${}^{\circ}$  ${}^{\circ}$ 5mm、好ましくは0.2~1mmである。

【0065】上記の様にして得られた透明樹脂基板は、 液晶、有機ELなどのディスプレー基板、光学フィルタ 一、光通信材料、太陽電池基板などの各種用途に好適に 利用される。

[0066]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明は、その要旨を超えない限り、以下の実 施例に限定されるものではない。

【0067】実施例1

<光重合性モノマー組成物の調製>ビス(オキシメチ ル)トリシクロ[5,2,1,014]デカンージアク リレート94重量%とペンタエリスリトールテトラキス (B-チオプロピオネート)6重量%との混合物100 重量部に対し、光重合開始剤として、ベンソフェノン 0.05重量部と2、4、6-トリメチルペンゾイルジ フェニルフォスフィンオキサイド 0.05 重量部、増粘 剤として日本ゼオン社製「ZEONEX450」(ノボ ルネン系開環重合体の水素添加物)3重量部を添加し、

を調製した。

[0068] <透明樹脂基板の製造設備>図1に示すの と同様の製造設備を使用した。下部支持シート(20) 及び上部支持シート(30)には幅330mmで厚さ1 00μmのポリエステルシート (三菱化学ポリエステル 社製「〇300」)、活性線照射設備(4)及び(6) にはメタルハライドランプ(日本電池社製)、耳部切断 用カッター(5)には水冷式25 W炭酸ガスレーザー (カンタムエレクトロニクス社製) をそれぞれ使用し

【0069】<透明樹脂基板の製造>先ず、下部支持シ ート(20)及び上部支持シート(30)の移送速度を 1m/minsとし、ダイコーター(1)から下部支持 シート(20)上に光重合性モノマー組成物(A)を供 給し、幅310mmで厚さ400μmのシート状に成形 した。

【0070】次いで、前段硬化工程用活性線照射設備 (4)により0.5分間で2J/cm²の照射を行なっ た。この際、光重合性モノマー組成物(A)の温度は、 ベアを兼ねているが、下部支持シート(20)の下部に 20 空冷により130℃に保持した。因みに、前段硬化にお いては、光重合性モノマーの約60重量%の重合が行わ

> 【0071】次いで、耳部切断用カッター(5)により 両端から20mmの位置で耳部を切断して除去した後、 巻取装置(25)及び(35)で両支持シート(20) 及び(30)をそれぞれ剥離した。

【0072】次いで、後段硬化工程用活性線照射設備 (6)により5分間で25J/cm'の照射を行なっ た。との際、光重合性モノマー組成物(A)の温度は、 切断して透明樹脂基板製品(B)を得た。

【0073】約50mの透明樹脂基板製品が得られるま で50分間に亘り連続的に透明樹脂基板の製造を行なっ た。その間、光重合性モノマー組成物(A)のシートの 破断などの問題は起とらなかった。また、得られた透明 樹脂基板製品(B)について、10cm角に切り出して 高さの変動(うねり)を測定した結果1mmであった。 【0074】比較例1

実施例1において、前段硬化工程用活性線照射設備 (4)による照射量を0.3J/cm1、後段硬化工程 用活性線照射設備(6)による照射量を25 J/cm<sup>1</sup> に変更した以外は、実施例1と同様にして透明樹脂基板 製品(B)を得た。50分間の連続製造中には光重合性 モノマー組成物(A)のシートの破断などの問題は起こ ちなかった。しかしながら、透明樹脂基板製品(B)の うねりは4mmであった。

【0075】比較例2

実施例1において、前段硬化工程用活性線照射設備 (4) 及び後段硬化工程用活性線照射設備(6) による 粘度3000mPa·secの光重合性モノマー組成物 50 照射量を共に13J/cmiに変更した以外は、実施例

14

(8)

特開2002-12682

デーマコート (参考)

13

1と同様にして透明樹脂基板製品(B)を得た。50分 間の連続製造中に光重合性モノマー組成物(A)のシー トの破断が5回起とり、しかも、透明樹脂基板製品

(B)のうねりは8mmであった。

[0076]

【発明の効果】以上説明した本発明によれば、均一且つ 平坦な表面を有する透明樹脂基板の安定した連続的製造 方法が提供され、本発明の工業的価値は顕著である。

【図面の簡単な説明】

【図1】発明を実施するための製造設備の好ましい一例 10 32:案内ローラ の説明図

【符号の説明】

1:ダイコーター

4:前段硬化工程用活性線照射設備

5:耳部切断用カッター

\*6:後段硬化工程用活性線照射設備

20:下部支持シート

21:下部支持シート送給装置

22:駆動ローラ

23:案内ローラ

24: 案内ローラ

25:下部支持シート巻取装置

30:上部支持シート

31:上部支持シート送給装置

33:案内ローラ

34:案内ローラ

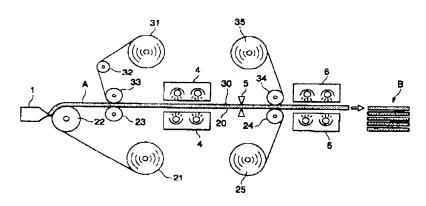
35:上部支持シート巻取装置

A:光重合性モノマー組成物

B:透明樹脂基板製品

"Herit"

[図1]



フロントページの続き

Cagner.

(51)Int.C1.'

B29L 7:00

識別記号

FΙ

B29L 7:00

CO8L 57:00

(72)発明者 石原 充

C 0 8 L 57:00

三重県四日市市東邦町1番地 三菱化学株

式会社四日市事業所内

(9)

特開2002-12682

F ターム(参考) 4F071 AA33 AF29 AF30 AI12 AH19 BA02 BB02 BB12 BC01 BC03 BC08 - 4F073 AA05 AA07 BA18 BB01 CA45 FA03 HA09 HA11 - 4F204 AD05 AD08 AD35 AE10 AC03 AH73 AK03 AR06 EA04 EB02

EK18

4J011 AA04 AA05 AC04 BB10 CA08
CC10 QA03 QA45 SA01 SA22
SA26 SA29 SA61 SA84 TA02
TA03 UA01 VA01 VA02 WA07

EB11 EE02 EF36 EK04 EK17

TipH.